

# 第3回 異種材料接合技術研究会 (全3回)

主催：(公財)科学技術交流財団 協力：愛知工研協会

昨今、異種材料の接合技術は自動車や電子、電機分野で積極的に利用されており、企業の方々の関心が高まっています。従来では困難とされた異種材料の接合技術の革新は目覚ましいものがあり、新たな材料を組み合わせることで、製品の軽量化や機能・性能の向上、コスト削減に寄与するものと期待されています。

こうしたことから、当財団では企業の方々の新事業創出、新商品開発などに役立ていただくことを目的とし、異種材料接合の最新の状況について、専門家を招聘してご講演いただく研究会を昨年度に続き3回にわたり開催することとしました。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

## 《第3回》

日時：平成28年12月20日(火)

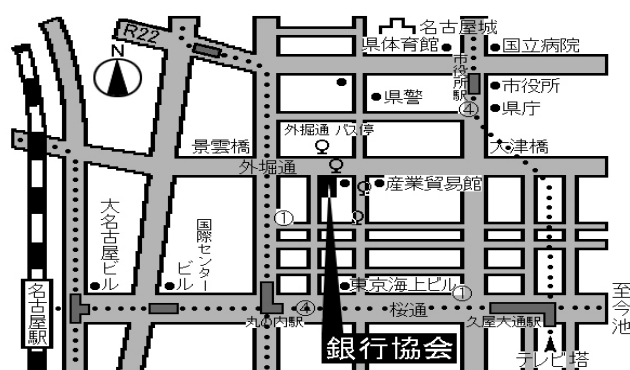
13:30~16:50

場所：名古屋銀行協会 2階 201会議室

名古屋市中区丸の内2-4-2

TEL 052-231-7851

定員：80名(定員に達し次第締め切ります)



- 地下鉄 桜通線「丸の内」下車④出口 徒歩5分  
鶴舞線「丸の内」下車①出口 徒歩5分  
名城線「市役所」下車④出口 徒歩8分
- 市バス 名古屋駅9番乗場より「外堀通」下車すぐ

## 《プログラム》

13:30~13:35 主催者挨拶

13:35~14:45 「有機ケイ素系ポリマーを用いたアルミニウム-セラミックス接合技術」  
講師 産業技術総合研究所 構造材料研究部門セラミック機構部材グループ  
主任研究員 北 憲一郎 氏

有機ケイ素系ポリマーはセラミックス化可能な性質を有するポリマーであり、これまでに繊維や薄膜等のユニークな形状を持ったセラミック材料の原料として使われてきました。

今回は、この有機ケイ素系ポリマーを接合技術に応用した例について御紹介いたします。

14:45~15:00 休憩

15:00~16:10 「新しい金属/樹脂接合技術『DLAMP (ディーランプ)』のご紹介」  
講師 ダイセルポリマー株式会社 新事業企画部 主席部員 柴田 悟 氏

マルチマテリアル化は自動車分野、各工業分野で期待されている技術です。本講演では、レーザーエッチング法を用いた、まったく新しい樹脂/金属接合技術『DLAMP (ディーランプ)』について、その開発背景から接合メカニズム、適用用途などを紹介させていただきます。

16:10~16:50 講師との名刺交換(自由参加)

◆**申込方法** 下記申込書にご記入の上、12月13日(火)までにFAX又はメール(chusyo@astf.or.jp)にてお申込み下さい。  
科学技術交流財団HPからもお申込みいただけます。  
ホームページ：<http://www.astf.or.jp/astf/hukyu/bunya/h28k103.html>

◆**参加費** 全3回 5,000円  
(研究交流クラブ会員・愛知工研協会会員の方は3,000円)

◆**お支払方法** 研究会前日までに、以下の銀行口座にお振込み下さい。  
振込手数料はご負担願います。

銀行名：三菱東京UFJ銀行『愛知県庁出張所』(店番号191)
口座番号：(普通)1031946
口座名義： <small>コウエキザイダンホウジン カガクギジュツコウリユウザイダン リジチョウ ハマグチミチナリ</small> 公益財団法人 科学技術交流財団 理事長 濱口道成

◆**お問い合わせ先** 当財団 業務部 0561-76-8325

第3回 異種材料接合技術研究会 参加申込書

FAX 0561-21-1651

(公財)科学技術交流財団 業務部 行 担当:山岸/松田

ふりがな	
会社名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX
	メールアドレス

※ ご記入いただいた個人情報は、当財団からの各種連絡・情報提供のために利用させていただきます。

※ 受講票は発行いたしません。直接会場にお越しください。